

2006年11月21日

ディスプレイ用回路接続フィルムの新工場を建設

－2007年8月から生産能力を70%増強へ－

日立化成工業株式会社（本社：東京、執行役社長：長瀬 寧次、資本金：154億円）は、FPD（フラットパネル・ディスプレイ）の回路接続に用いられる回路接続フィルム「アニソルム®」のさらなる事業拡大を図るため、今般約25億円を投じ、下館事業所（南結城）＜茨城県結城市＞に、生産能力400,000㎡（年間）の新工場を建設します。これにより、2007年8月から同製品の生産能力を、現在の約70%増強します。

FPD用回路接続フィルムは、主にFPDの信号入力回路と駆動用半導体ICチップの出力回路を接続したり、制御基板の出力回路と駆動用半導体ICチップの入力回路を接続するためのフィルム材料です。これは絶縁性接着剤層に導電性粒子を分散させ、フィルム加工を施したもので、使用条件により、導電性と絶縁性という異なる特性を局部的に持たせることができ、FPDのカラー化や高精細化の進展に大きな役割を果たしています。LCD（Liquid Crystal Display）のほか、PDP（Plasma Display Panel）や有機EL（Electroluminescence）への採用も増加しています。

近年FPD市場は、ノート型パソコンやパソコン用モニター、フラットパネル・テレビ、携帯電話等の分野へ急速に用途を広げ、順調に成長を続けてきました。今後も、デジタル放送対応に向けたフラットパネル・テレビのさらなる普及、BRICsへのパソコン、携帯電話のさらなる浸透に伴い、回路接続フィルムの需要の拡大が見込まれています。

当社は、こうしたグローバルに拡大する需要に呼応し、顧客への安定供給を第一に考え、下館事業所（南結城）に新工場の建設を決定しました。これにより、現在、本製品を製造する五所宮事業所＜茨城県筑西市＞との2製造拠点体制を確立し、今後も事業の強化と売上拡大を図ってまいります。

〔新工場建設の概要〕

設置場所	茨城県結城市大字鹿窪 1772-1 [当社下館事業所（南結城）内]
建屋床面積	3,200㎡
完成予定時期	2007年7月
稼動開始予定	2007年8月
生産能力	年間400,000㎡
設備投資額	約25億円

以上

（報道関係お問い合わせ先）

日立化成工業株式会社 経営企画室 広報担当 長谷川、金成 TEL 03-5381-2371, 2374